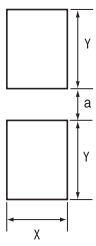


表面安装品

■推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

● 芯片型铝电解电容器普通结构品



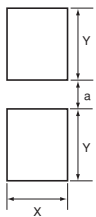
尺寸	X	Y	a
φ4	1.6	2.6	1.0
φ5	1.6	3.0	1.4
φ6.3	1.6	3.5	1.9
φ8×5.4L、φ8×6.2L	2.5	4.0	2.1
φ8×10L	2.5	3.5	3.0
φ10	2.5	4.0	4.0
φ12.5	2.0	7.3	3.0
φ16	2.0	7.9	5.3
φ18	2.0	8.9	5.3

● 导电性高分子铝固体电解电容器

尺寸	X	Y	a
φ5	1.6	3.0	1.4
φ6.3	1.6	3.5	2.1
φ8	2.0	3.5	3.0
φ10	2.0	4.0	4.0

● 导电性高分子品 (FPCAP)

(RPS, RPA, RHS, RHA, RSS, RSA, RSB, RFS, RFA, RSL, RDS, RCS, RDE, RKS,



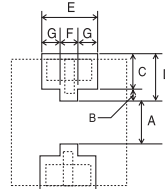
尺寸	X	Y	a	
FPCAP	φ4	1.6	2.6	1.0
	φ5	1.6	3.0	1.4
	φ6.3	1.6	3.5	2.1
	φ8	1.9	4.2	2.8
	φ10	1.9	4.4	4.3

● 芯片型铝电解电容器抗振结构产品

① φ6.3~10

尺寸	X	Y	a
φ6.3×7.7L	3.0	4.0	1.6
φ6.3×10 L	3.0	4.0	1.6
φ8×10 L	4.3	5.3	2.0
φ10×10 L	4.3	5.6	3.3

② φ12.5~18



尺寸	A	B	C	D	E	F	G
φ12.5	3.0	2.3	5.0	7.3	7.0	2.0	2.5
φ16	5.3	2.9	5.0	7.9	7.0	2.0	2.5
φ18	5.3	3.1	5.8	8.9	11.0	2.0	4.5

● 导电性高分子铝固体电解电容器抗振结构品 (PCX, PCR, PCM, PCH, PCZ)

尺寸	X	Y	a
φ6.3×8L	3.0	4.0	1.6
φ8×10.5L	4.3	5.3	2.0
φ10×10.5L	4.3	5.6	3.3
φ10×13.2L	4.3	5.6	3.3

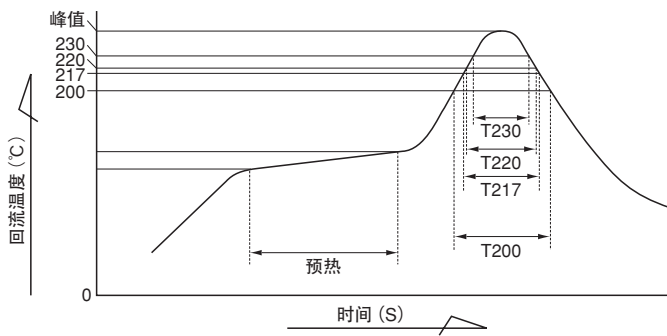
● 导电性高分子混合铝电解电容器普通结构品

尺寸	X	Y	a
φ6.3	1.6	3.5	1.9
φ8	2.5	3.5	3.0
φ10×10L、φ10×12.5L	2.5	4.0	4.0
φ10×16.5L	2.8	4.3	3.5

● 导电性高分子混合铝电解电容器抗振结构品

尺寸	X	Y	a
φ6.3×7.7L	3.0	4.0	1.6
φ8×10 L	4.3	5.3	2.0
φ10	4.3	5.6	3.3

芯片型回流焊接的推荐条件



T200 : 电容器表面超过+200°C的时间  
 T217 : 电容器表面超过+217°C的时间  
 T220 : 电容器表面超过+220°C的时间  
 T230 : 电容器表面超过+230°C的时间  
 温度测量点: 铝壳头部  
 超出容许范围使用时请咨询我们。

No.	品种·系列名称	尺寸	预热	峰值温度	超过230°C的时间	超过220°C的时间	超过217°C的时间	超过200°C的时间	回流次数
1	芯片型导电性高分子铝固体电解电容器 (PCF, PCJ, PCK, PCG, PCS, PCL, PCY, PCW, PCV, PCX, PCR, PCA, PCM, PCH, PCZ)	-	150~200°C, 60~180秒以内	260°C Max.	60s以内	-	70s以内	-	仅限1次 (部分系列※3) 2次以内※4
		-		250°C Max.	60s以内	-	70s以内	-	2次以内※4
2	导电性高分子混合铝电解电容器 (GYA, GYB, GYC, GYD, GYE, GYF, GYG, GXC, GWC)	-		260°C Max.	40s以内	-	50s以内	-	仅限1次
		-		250°C Max.	30s以内	-	40s以内	-	2次以内※4
3	芯片型铝电解电容器 (UZT, UWP, UWT, UWG, UUP, UUA, UUL, UCW, UCD※1, UCL, UCM※1, UCV, UUD, UUB※2, UCJ, UCZ※1, UCH, UCN, UCX※1, UUX※2, UUQ, UCQ, UUE※1, UBC※1, UBH)	~φ10		250°C Max.	30s以内	-	40s以内	-	2次以内※4
4	芯片型铝电解电容器 (UZG)	3.9L	150~180°C, 120秒以内	240°C Max.	-	30s以内	30s以内	-	2次以内※4 (φ6.3: 仅限1次)
5	芯片型铝电解电容器 (UUX (160-400V), UUB (160-400V), ULT, ULH, ULR, ULV)	~φ10		240°C Max.	-	30s以内	30s以内	-	2次以内※4
6	芯片型铝电解电容器 (UCD, UCM, UCK, UCZ, UYA, UCX, UUG, UUJ, UUN, UUE, UBC)	φ12.5~		240°C Max.	-	-	30s以内	60s以内	2次以内※4
7	芯片型铝电解电容器※5 (UWZ, UWD, UWH)	-		260°C Max.	60s以内	-	70s以内	-	2次以内※4 (φ8×6.2L和φ10×10L: 仅限1次)

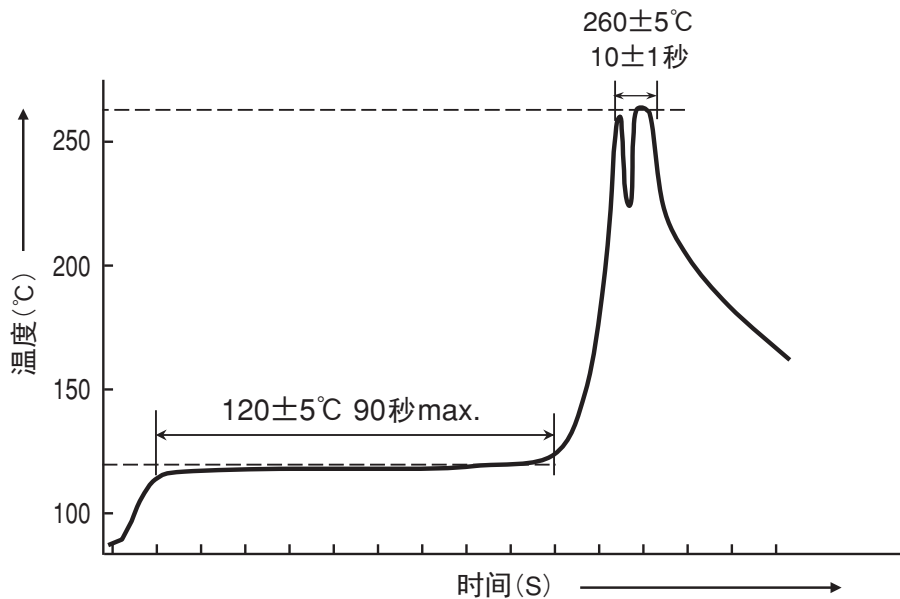
s=秒

- ※1: φ12.5~请参照No.6.
- ※2: 160~400V请参照No.5.
- ※3: 包括PCR, PCA, PCM, PCH 和 PCZ 系列。
- ※4: 请在第1次和第2次回焊之间留出充分的产品冷却时间。
- ※5: 高温回焊对应品。

**关于商品目录中记载的ESR阻抗值**

引线型: 测定位置为引线端子底部。  
 芯片型: 测定位置为距离树脂板的孔口最近的电极部。  
 除非另有记载说明, 否则均为初始值。

## 引线型铝电解电容器 流焊焊接的建议条件



流焊焊接的建议条件  
 预热：120 ± 5°C 90秒 max.  
 流动：260 ± 5°C 10 ± 1秒  
 测温位置  
 基板背面端子部位（见图 - 温度测量位置）

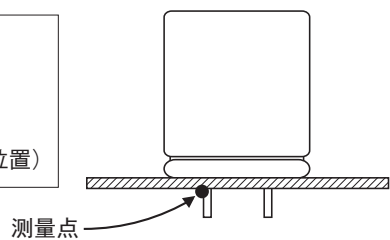


图 - 温度测量位置

## 烙铁焊接的建议条件

烙铁头温度：350 ± 10°C 3 + 1 / - 0秒

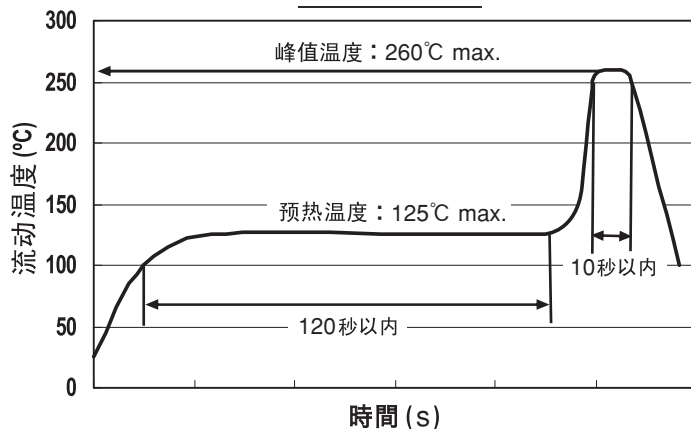
※导电性高分子铝固体电解电容器不包括在内，请另外单独联系我们。

**FPCAP** 无铅及RoHS指令适合焊接条件

流动焊 (引线型)

RNS、RR7、RR5、RL8、RE5、RS8、RF8、RNU、RNE、RNL、RS6、RHT

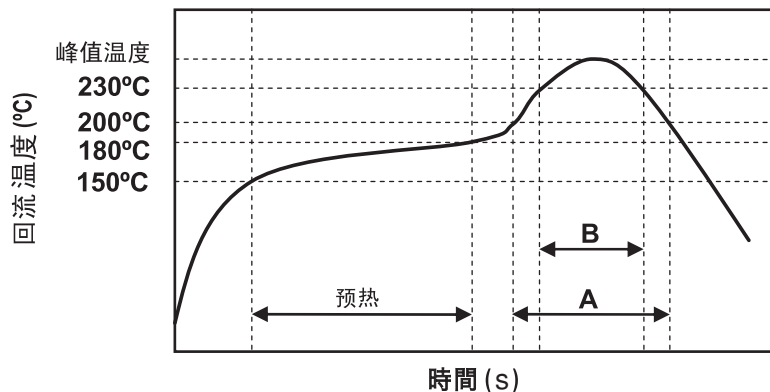
推荐流动条件



回流焊 (芯片型)

RPS、RPA、RHS、RHA、RSS、RSA、RSB、RFS、RFA、RSL、RDS、RCS、RDE、RKS

推荐回流焊条件



項目	推荐条件 1	推荐条件 2	推荐条件 3
系列名称	RPS、RPA、RHS、RHA、RSS、RSA、RSB、RFS、RFA、RSL、RDE		RDS、RCS、RKS
峰值温度	260°C max.	250°C max.	260°C max.
预热	150~180°C 90秒以内	150~180°C 90秒以内	150~180°C 90秒以内
A	200°C 以上 60秒以内	200°C 以上 60秒以内	200°C 以上 60秒以内
B	230°C 以上 40秒以内	230°C 以上 40秒以内	230°C 以上 40秒以内
回流次数	1次	2次以下	2次以下